

Produkt Datenblatt Typ: PO50-50-25-AL-1

Gruppe: Powerblocs

Powerblocs eckig

Breite: 50 mm Höhe: 25 mm 50 mm Länge: Bodenstärke: 3.5 mm Minimaler Wärmewiderstand: 4.0 K/W Halbleitermontage: Kleben Kühlkörpermontage: Kleben Oberfläche: Pressblank Al99.5 Material:



- 169 Stifte
- Kühlkörper für Mikroprozessoren (Fliesspresstechnik)
- Direktmontage durch Selbstklebefolie möglich
- Zusätzliche verbesserte Wärmeleitung durch reine Aluminiumlegierung (Al 99,5; 210-236 W/mK) und hohe Materialdichte
- Anordnung und Anzahl der Stifte für optimalen Luftdurchsatz
- gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung
- für erzwungene und freie Konvektion geeignet
- RthK- Werte gelten für natürliche Konvektion (ohne Fremdbelüftung)
- kundenspezifische Modifikationen und Sonderausführungen, andere Stiftlängen und Oberflächen auf Anfrage.

